

PASTA TÉRMICA Z85

2g - 8.5W/m-K

Presentación	Jeringa con 2g de pasta
Color	Gris
Conductividad térmica	8.5W/m-K
Resistencia térmica	< 0.028°C-in ² /W
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 150°C
Composición	<ul style="list-style-type: none">- Compuestos de silicona: 20%- Compuestos de carbón: 12%- Óxidos metálicos: 68%
P/N	COO-TGZ8W-2
EAN	8436624423604

Descripción

Compuesto térmico eléctricamente no conductor y de baja resistencia térmica, formulado con un alto contenido de óxidos metálicos. Garantiza una excelente transferencia de calor entre componentes como CPU, memorias y chipsets gráficos hacia el sistema de refrigeración, mejorando la disipación térmica y el rendimiento del equipo.

Modo de aplicación

Asegúrese de que la superficie de contacto (CPU, disipador, etc.) esté completamente limpia y libre de residuos.

Aplice una pequeña cantidad de pasta térmica en el centro de la superficie. Extiéndala de forma uniforme con el aplicador incluido hasta obtener una capa fina y homogénea.

Instale el sistema de refrigeración inmediatamente después de la aplicación. Conserve el producto restante para futuras aplicaciones, manteniéndolo correctamente cerrado.

